

3月です。暦の上ではとっくに春、気温も少しずつ上がり、日差しも柔らかくなってきました。よくぞ耐え抜きました。
ところが、穏やかに喜べないのは、花粉という名の“無差別攻撃”。外に出た瞬間に目と鼻が同時に反乱を起こし、「戦いはまだ終わっていないのか」なんて思います。
春は本来、生命の芽吹きや新しい始まりを象徴するはずなのに、花粉症の人にとっては“試練の季節”。もし鬼が本当に存在するなら、2月の豆よりも3月のスギ花粉のほうがよほど強力です。豆では倒せない鬼も、花粉を浴びせれば一撃で退散するかもしれません。むしろ人間のほうが先に倒れますが。
さらに3月には、年度末という別の“見えない敵”も潜んでいます。書類の締め切り、予算の調整、年度末進行のスケジュール…。これらは豆でも花粉でも倒せません。強いて言えば、コーヒーと気合いと、ちょっとした現実逃避が武器になるくらいです。
それでも、春は確実に近づいています。桜のつぼみは膨らみ、日が長くなり、冬の重たい空気が少しずつほぐれていく。花粉に泣かされ、年度末に追われながらも、どこか前向きになれるのが3月の不思議なところですよ。
どうぞ、花粉にも年度末にも負けず、軽やかに春を迎えてください。
鬼より強いのは、結局のところ、毎年なんだかんだ乗り越えていく私たち自身なのかもしれません。

▼ I N D E X ▼

- 【技術関連情報】 ・ C P O (Co-Packaged Optics)
- 【関連製品紹介】 ・ 近紫外高出力ファイバーレーザー光源
- 【お知らせ】 ・ 『O P I E ’ 2 6 レーザー E X P O 』に出展します

■技術関連情報■

C P O (Co-Packaged Optics)

現代社会ではネットワーク通信の爆発的なデータ量の増加により、通信帯域幅の高密度化、通信の遅延、銅線での到達距離限界、電力効率などの課題が生じています。これに対するアプローチとして、Co-Packaged Optics (CPO) という技術が注目されています。
CPOとは、光通信の光学部品と半導体チップを同一基板上に実装する技術でプリントを削減し、高速通信、省電力化、低遅延化を実現します。
ただし、高密度化・複雑かつ精密な実装には課題もあり、発熱対策、デバイス信頼性、量産歩留まり向上等を解決していかなくてはなりません。
大きく重くコストをかければ、大抵のことは出来てしまうのですが、小さく軽く低コストでのモノづくりは、まだまだ簡単なことではありません。
弊社は、お客様の課題をオプトメカトロニクスの総合力で解決出来ればと考えており、本技術の3次元実装に必要な露光機用の近紫外、中出力レーザー光源も設計、製作しております。

CPOとは (東京エレクトロニクス)
<https://www.inrevium.com/pickup/cpo/>

CPO (Co-Packaged Optics) がデータセンターを変えるか (News Pics)
<https://newspicks.com/news-in-app/15908896/>

AI ファクトリーを数百万の GPU に拡張するため、コパッケージド
オプティクス ネットワーク スイッチ、Spectrum-X Photonicsを発表 (NVIDIA)
<https://blogs.nvidia.co.jp/blog/nvidia-spectrum-x-co-packaged-optics-networking-switches-ai-factories/>

(高田)

■関連製品情報■

近紫外高出力ファイバーレーザー光源

本文でも紹介の様に近紫外高出力ファイバーレーザー光源は色々な分野で使用されています。

こんなことがレーザーでできないか、これをレーザーで測れないかなどございましたらお問い合わせください。

近紫外高出力ファイバーレーザー光源

<https://www.alt.co.jp/laser-light-source#ttl-navi11>

■お知らせ■

『OPIE' 26レーザーEXPO』に出展します

日時：2026年4月22日（水）～24日（金）

10時～17時

場所：パシフィコ横浜

展示ホール ブース A-07

入場には事前登録が必要です

<https://www.opie.jp/visitors/register/>
